

### 关键指标

频率: 6~18GHz

增益: 16.5dB

1dB 压缩点输出功率: 18dBm

电压/电流: +5V/98mA

芯片尺寸: 1.2mm×1.1mm×0.1mm

### 产品简介

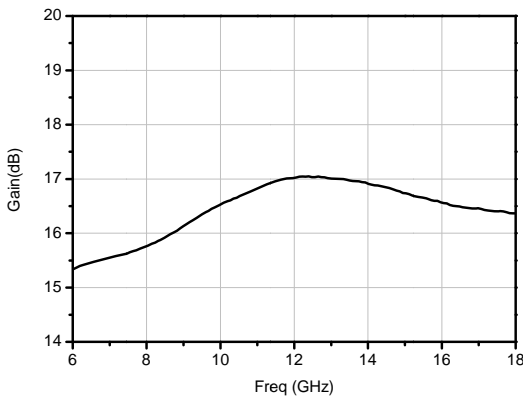
HG126FB 是一款 6~18GHz 驱动放大器芯片, 增益为 16.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 18dBm。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)

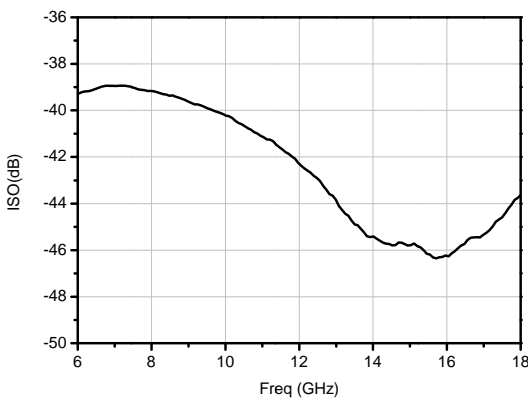
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
增益(dB)	-	16.5	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波(dB)	-	1.6	-
输出驻波(dB)	-	1.2	-
隔离度 (dB)	-	42	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	18	-
静态电流 (mA)	-	98	-

### 典型测试曲线

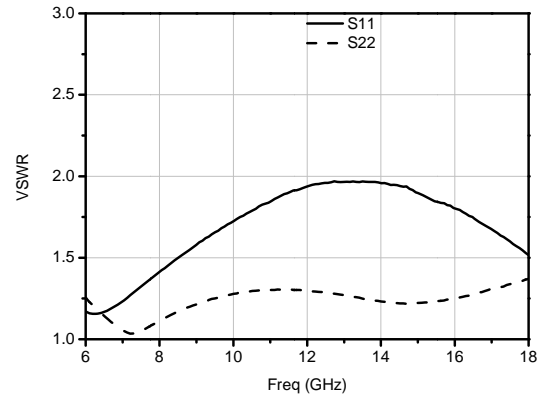
增益



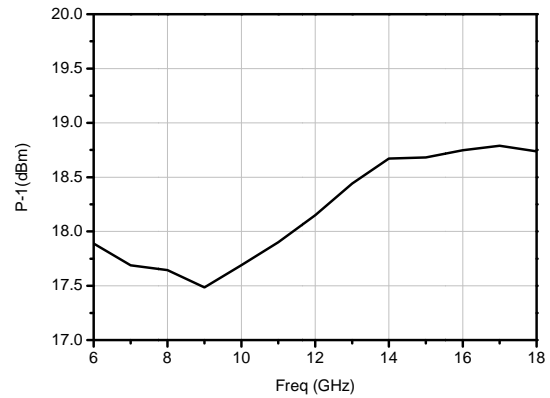
反向隔离度



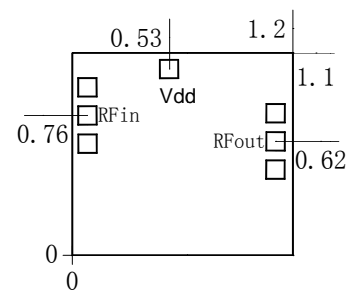
驻波



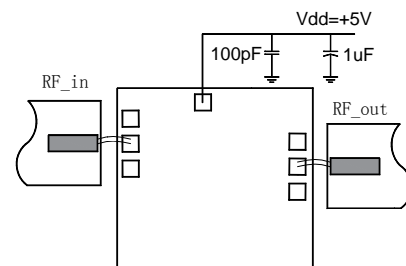
1dB 压缩点输出功率



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图



### 绝对额定最大值

电源电压	+5.5V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~85°C
存储温度	-65°C~150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50 $\mu$ m 双金带键合，建议金带长度 250~400 $\mu$ m；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。